



2016 智能卡精益制造研讨会

尊敬的_____先生/女士，您好！

2016 智能卡精益制造研讨会将于2016年03月在重庆召开。

会议通知

智能卡产品经过这几年不断的高度竞争状态下，产品的利润在迅速的下滑，与此同时智能卡制造面临着各种成本上升的压力。全自动精益生产在很多其他制造领域都已经陆续开展，智能卡行业这个经历了20多年的老牌“智能”行业还依旧在精益制造这条路上摸索着。降耗、节能、创新始终是智能卡制造工程师们心中永恒的目标，也是行业始终探讨的话题。

2016年3月25日，SCA联盟将邀请智能卡行业各路精兵强将共同探讨这一话题。打开思路、开放视野、集思广义、合作共赢。

讨论要点



芯片模块小型化加工工艺



卡片印刷工艺的进展



芯片模块封装的新材料



精益化的全自动生产线



条带工艺的最新发展



新型卡体材料



卡片表面工艺创新



智能卡厂的智能化管理



卡片个人化工艺最新发展



数字时代下智能卡厂的升级与转型

谁将参加



智能卡制造商



智能卡设备商



智能卡芯片商



智能卡芯片封装厂



智能卡芯片商



智能卡芯片材料商



智能卡条带商



智能卡粘接材料商



智能卡卡体材料商



智能卡印刷材料商



智能卡INLAY商



自动化生产管理专家

会议日程

会议嘉宾

会议门票

智能卡厂参会:1200元/人

包含会议入场券、午餐、2次茶歇、会议演讲资料下载

其它参会 : 2000元/人

包含会议入场券、午餐、2次茶歇、会议演讲资料下载

